

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2026-051

太龙电子股份有限公司

关于全资子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司香港仁天半导体科技有限公司（以下简称“香港仁天半导体”）近日与联宝（合肥）电子科技有限公司（以下简称“合肥联宝”）签订了合作协议。为了满足关联公司的经营需要，促进公司业务的开展，公司全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司（以下简称“全芯科微”）为香港仁天半导体与合肥联宝的合作协议提供不超过46,000万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行全芯科微内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会。

二、被担保人的基本情况

（一）香港仁天半导体科技有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人英文名称	HONGKONG KINGSKY SEMICONDUCTOR CO., LIMITED
被担保人中文名称	香港仁天半导体科技有限公司
注册日期	2025年10月17日
注册号码	78966886
注册地址	香港湾仔骆克道300号浙江兴业大厦12楼A室
主营业务	电子贸易及电子产品的设计及咨询，技术外包
与上市公司存在的关联关系	为上市公司的控股子公司

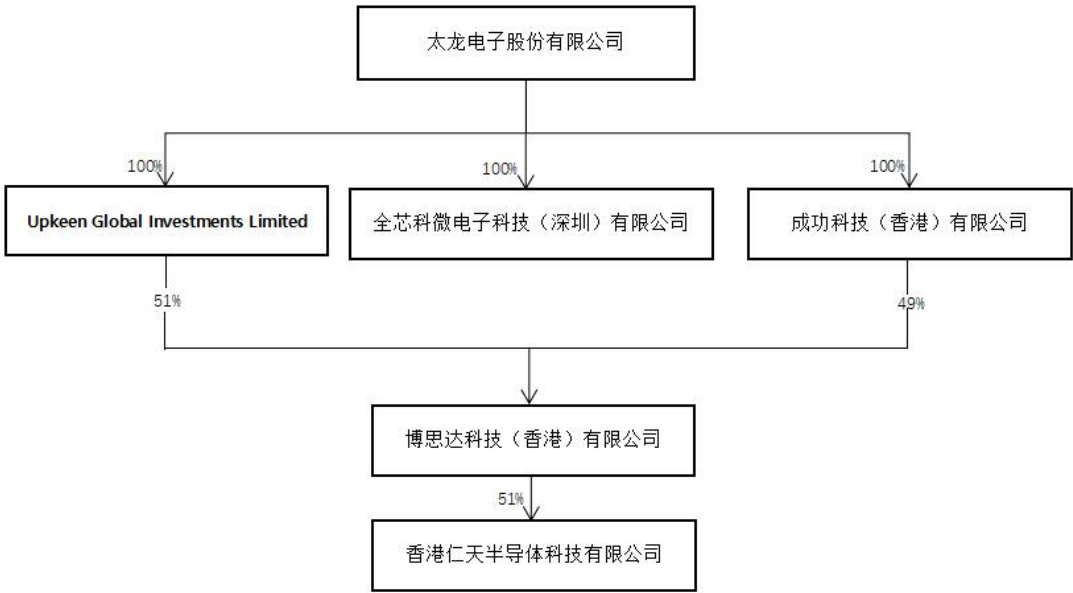
2、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	-	18,963.37
负债总额	-	18,716.13
应收账款	-	4,864.38
净资产	-	2,47.24
项目	2025 年年度 (经审计)	2026 年 1 月-6 月 (未经审计)
营业收入	-	5,270.84
营业利润	-	257.57
净利润	-	215.07

注：香港仁天半导体为新设公司，2025 年度尚未经营，因此无相关数据。

(二) 担保人与上述被担保人股权结构如图所示：



三、保证函的主要内容

- 1、债权人：联宝（合肥）电子科技有限公司
- 2、保证人：全芯科微电子科技（深圳）有限公司
- 3、债务人：香港仁天半导体科技有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证

5、被担保最高债权额：本保证函项下的全部责任不超过人民币 46,000 万元另加合肥联宝行使保证函项下权利和救济所发生的费用。

6、保证范围：为香港仁天半导体在主合同项下应向合肥联宝支付的全部款项，包括但不限于货款、退款、滞期费、违约金、损害赔偿金、主合同履行过程中给合肥联宝人员和财产造成的损害赔偿费用、因未按主合同约定履行而使合肥联宝增加的支出、合肥联宝行使主合同项下权利和救济所发生的费用（包括但不限于律师费）。

7、保证期间：保证债务履行期限届满之日起两年。

8、反担保条款：无。

9、其他相关事项：香港仁天半导体的其他法人股东的实际控制人也签订了担保函，对主合同项下债权提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 8 月 27 日，公司实际担保余额为人民币 38,752.11 万元或等值外币（不含本次担保），占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 30.71%。

除此之外，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

五、备查文件

1、《最高额保证函》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日